

Title (en)

Joint sealing profile and method for its production

Title (de)

Fugenfüllungsprofil und Verfahren zu seiner Herstellung

Title (fr)

Profilé de remplissage de joint et son procédé de fabrication

Publication

EP 2098651 A2 20090909 (DE)

Application

EP 09002901 A 20090228

Priority

DE 102008012302 A 20080303

Abstract (en)

The method involves carrying out a joint enlargement at free upper edges of prefabricated plates adjacent to each other. The joint enlargement runs horizontally. The joint is filled in the joint enlargement with joint sealing compound in surface binding manner. An independent claim is included for a joint filling profile for forming a joint sealing suitable for prefabricated technique.

Abstract (de)

Um ein Verfahren zur Herstellung einer für neue geeignete Fugenfüllungen zwischen Bodenplatten sowie entsprechende Fugenfüllungsprofile anzugeben, bei welchen Flankenabrisse im Dehnfugenbereich auf ein Minimum reduziert, vorzugsweise verhindert werden und die den unterschiedlichen oben genannten Anforderungen genügen, wird mit vorliegender Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer für fertigteiltechnische Anwendungen geeigneten Fugenabdichtung zwischen Fertigteilplatten vorgeschlagen, wobei an den freien oberen zueinander weisenden Kanten benachbarter Fertigteilplatten eine im Wesentlichen horizontal verlaufende Fugenverbreiterung ausgeführt wird und die Fuge mit Fugenvergussmasse oberflächenbündig bis in die Fugenverbreiterung verfüllt wird.

IPC 8 full level

E04F 15/02 (2006.01); **E04B 1/68** (2006.01)

CPC (source: EP)

E04B 1/6801 (2013.01); **E04B 1/6804** (2013.01); **E04F 15/02016** (2013.01)

Citation (applicant)

- DE 10002866 A1 20010816 - ULBRICH REINER [DE]
- DE 2948543 A1 19810604 - MANNESMANN AG [DE]
- DE 29710530 U1 19970814 - SCHLUETER SYSTEMS GMBH [DE]
- GB 1406539 A 19750917 - THIOKOL CORP
- DE 2904236 A1 19800807 - SECUPLAN BELAGTECHNIK GMBH
- DE 8313075 U1 19881020
- US 3810707 A 19740514 - TUNGSETH B, et al
- US 3334558 A 19670808 - ATKINSON RAY N

Cited by

DE202019101140U1; DE202016102430U1; CN111764522A; CN114960988A; DE102014003803A1; CN113718967A; CN105714942A; CN109881864A; US11359367B2; DE202022104190U1; EP3702531A1; EP3241953A1; EP3412842A1; EP3460135A1; US10577806B2; EP3757313A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA RS

DOCDB simple family (publication)

EP 2098651 A2 20090909; **EP 2098651 A3 20120627**; **EP 2098651 B1 20170412**; DE 102008012302 A1 20090910

DOCDB simple family (application)

EP 09002901 A 20090228; DE 102008012302 A 20080303